

Presseinformation

5. Mai 2017

Doppelter Auftritt in Nürnberg: Henkel präsentiert sein Material-Know-how auf der PCIM und der SMT Hybrid Packaging

Henkel setzt auf starke Präsenz auf der PCIM Europe und der SMT Hybrid Packaging mit seinen innovativen Produkten für Wärmeableitung, Leiterplattenschutz und Lötprozesse

Düsseldorf – In diesem Monat wird Henkel sowohl auf der PCIM Europe (PCIM) als auch der SMT Hybrid Packaging (SMT) vertreten sein, die beide parallel vom 16. Bis 18. Mai in Nürnberg stattfinden. Am Henkel-eigenen Stand auf der PCIM (Halle 7, Stand 445) und bei einem gemeinsamen Auftritt mit Vertriebspartner AAT Aston auf der SMT (Halle 4, Stand 241) stellt der führende Materialhersteller seine neuesten Entwicklungen bei modernen Wärmemanagement-Lösungen, wärmeleitfähigen Produkten für den Low Pressure Molding und preisgekrönten Lötpasten vor.

Umfassendes Wärmemanagement bei Leistungsanwendungen

Die Henkel-Produktpalette für das Wärmemanagement deckt von der Leiterplattenbestückung bis hin zur Elektronik-Verkapselung das gesamte Lösungsspektrum zur Temperaturkontrolle ab. Die Besucher der PCIM und der SMT können sich über isolierte T-Clad-Metallsubstrate (IMS), hochwärmeleitfähige Gap Filler und Wärmeleitmaterialien der Serie Gap Pad ebenso informieren wie über Phase-Change-Materialien und das wärmeleitfähige Technomelt TC 50 für den Low Pressure Molding

Jedes dieser Materialien bietet Vorteile für eine Vielzahl elektronischer Geräte, aber insbesondere für Anwendungen in der industriellen Automatisierung und dem Automobilsektor. T-Clad IMS Thermosubstrate sind ideal geeignet für SMT-Anwendungen mit höheren Leistungsdichten und leiten Wärme effektiver ab als

herkömmliche Leiterplatten. Für Geräte wie Leistungsmodule bieten die Phase-Change-Materialien der Reihe Loctite TCP 7000, die im Siebdruckverfahren oder mit Applikatoren aufgebracht werden können, eine überlegene Alternative zu herkömmlichen Wärmeleitfetten. Die Phase-Change-Materialien bleiben trocken, bis sie bei der spezifischen Phasenübergangstemperatur schmelzen und fließen, so dass sie vorappliziert oder während der Leiterplattenmontage aufgebracht werden können. Hochwärmeleitfähige Wärmeleitmaterialien, Gap Pad HC 3.0 (3,0 W/m-K) und Gap Pad HC 5.0 (5,0 W/m-K) sowie der Gap Filler 4000 (4,0 W/m-K) und der Gap Filler 3500LV (3,5 W/m-K) mit niedrigem VOC-Gehalt sorgen für Flexibilität: Pad-basierte Produkte für ebene Oberflächen oder flüssige, hohlraumfüllende Wärmeleitmaterialien für komplexere, mehrstufige Architekturen.

Für Produkte, die eine Wärmeableitung durch die Verkapselungsschicht erfordern, wurde das wärmeleitfähige Technomelt TC 50 (www.technomelt-simply3.com) als Ersatz für herkömmliche Vergussmassen entwickelt. Technomelt TC 50 bietet eine Wärmeleitfähigkeit > 0,5 W/m-K in Kombination mit allen Vorteilen der Technomelt-Palette, wie hoher Durchsatz und Schutzeigenschaften.

Live-Vorführungen mit Technomelt TC 50 finden sowohl am Henkel-Stand auf der PCIM als auch im Henkel-Bereich des Standes von AAT Aston auf der SMT statt. Gap Filler und Muster anderer Produkte für das Wärmemanagement stehen auf der PCIM zur Verfügung.

Raumtemperaturstabile Lötpaste

Neben seinem Portfolio an Wärmemanagementlösungen präsentiert Henkel auch seine preisgekrönte temperaturstabile Lötpaste Loctite GC 10 (www.soldergamechanger.com) sowohl auf der PCIM als auch der SMT. Die Stabilität des Materials bietet Vorteile in allen Phasen, von Transport und Lagerung



über die herausragende Verarbeitbarkeit bei der Leiterplattenmontage bis hin zur Langzeit-Zuverlässigkeit. Loctite GC 10, das bis zu einem Jahr lang bei Raumtemperatur gelagert werden kann, wurde kürzlich im Rahmen einer Studie ([Studie herunterladen](#)) einem Vergleich mit drei anderen bekannten bleifreien Lötpasten unterzogen. Von allen untersuchten Materialien wies Loctite GC 10 den besten CpK-Wert (durchschn. Auftragsvolumen und Verteilung) bei anspruchsvollen Flächenverhältnissen von unter 0,66 auf. In Kombination mit den weiteren Vorteilen – keine Anlaufzeit, reduzierte Kühlungsanforderungen, 95 % Nutzungsrate mit entsprechend minimalem Materialverlust und einfaches Management – macht dies Loctite GC 10 zur branchenführenden Hochleistungs-Lötpaste. Zur Illustration der nicht-trennenden, nicht-trocknenden Eigenschaften des Materials werden Mustergläser mit Loctite GC 10 an den Henkel-Ständen zur Verfügung stehen.

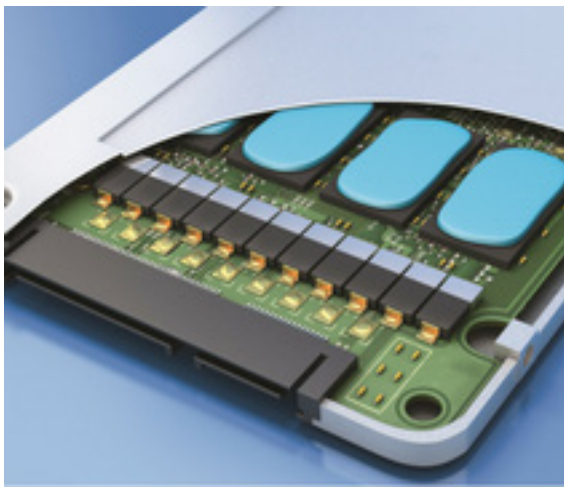
Für Termine mit einem Henkel-Experten auf der PCIM oder der SMT wenden Sie sich bitte per E-Mail an: mahmoud.awwad@henkel.com. Weitere Informationen zu den Henkel-Materiallösungen der nächsten Generation finden Sie unter www.henkel-adhesives.com/electronics.

Über Henkel

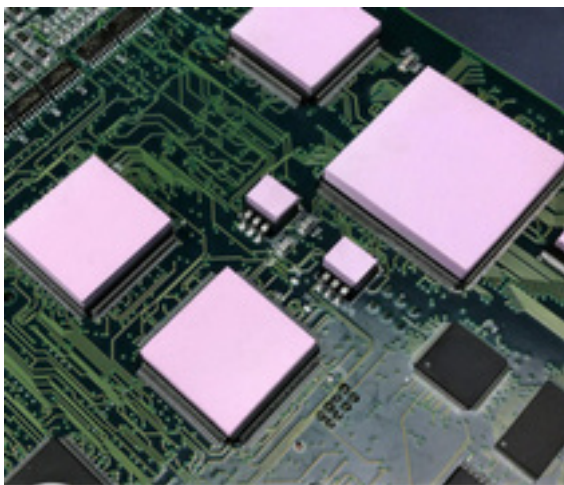
Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen – sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd Euro. Allein die drei Top-Marken Persil, Schwarzkopf und Loctite erzielten dabei einen Umsatz von mehr als 6 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.de/presse>

Kontakt Ines Behrendt
Telefon +49 211 797 6076
E-Mail electronics@henkel.com
Henkel AG & Co. KGaA



Gap Filler 4000 (4,0 W/m-K)



Wärmeleitfähiges Gap Pad HC 5.0 (5,0 W/m-K)